

MATELAS THERMOCONDUCTEURS

• THERM-A-GAP™ 569, 570, 579

Les THERM-A-GAP™ ont bénéficié d'une amélioration significative en termes de performances thermiques et d'adaptabilité par rapport aux précédents matelas thermoconducteurs et ont rapidement été très utilisés dans l'industrie.

Les versions 569 et 579 sont beaucoup plus souples que la version 570.

Caractéristiques et avantages :

- Force de fléchissement ultra-faible
- Conductivité thermique élevée
- Surface hautement collante réduisant la résistance de contact
- Version « A » fournie avec ruban adhésif repositionnable acrylique haute résistance permet tant une fixation permanente
- Indice d'inflammabilité reconnu UL V0
- Conforme aux spécifications RoHS
- Conforme au test de dégazage NASA

Matelas thermoconducteurs THERM-A-GAP™ 569, 570, 579			
Propriétés standard	569	570	579
Couleur	Gris	Bleu	Rose
Support G= Verre tissé-sans adhésive A= Feuille d'aluminium –avec adhésif	A ou G	A ou G	A ou G
Epaisseurs standard*, mm	0.25 – 5.0	0.5 – 5.0	0.25 – 5.0
Poids spécifique	2.2	2.2	2.9
Dureté, shore 00	10	25	30
Silicone extractible, %	10	10	6
Pourcentage de fléchissement à différentes pressions :	Fléchissement, %	Fléchissement, %	Fléchissement, %
- à 34 kPa			
- à 69 kPa	20	10	22
- à 172 kPa	30	15	33
- à 345 kPa	50	25	55
	65	35	68
Plage de températures de fonctionnement, °C	-55 à 200	-55 à 200	-55 à 200
Impédance thermique, °C.cm ² /w à 10 psi, à 1 mm d'épaisseur, version G	9.1	9.1	4.5
Conductivité thermique apparente, w/m.K	1.5	1.5	3
Capacité thermique, J/g.K	1	1	1
Coefficient de dilatation thermique, ppm/k	250	250	150
Force diélectrique, KVca/mm	8	8	8
Résistivité volumique, Ohm.cm	10	10	10
Constante diélectrique à 1 000 kHz	6.5	6.5	8.0
Coefficient de dissipation à 1 000 kHz	0.013	0.013	0.010
Indice d'inflammabilité	V0	V0	V0
Conforme aux spécifications RoHS	Oui	Oui	Oui
Dégazage, % TML	0.42	0.35	0.19
Durée limite de stockage, en mois à partir de la date d'expédition	24	24	24

- 569 :** - Peu coûteux, bonnes performances thermiques
 - Force de fléchissement ultra faible pour des applications à faible contrainte
 - Conçu pour répondre aux problèmes d'empilages d'écart de tolérance importants
 - Version « G » disponible en épaisseurs de 0.25 mm et 0.40 mm

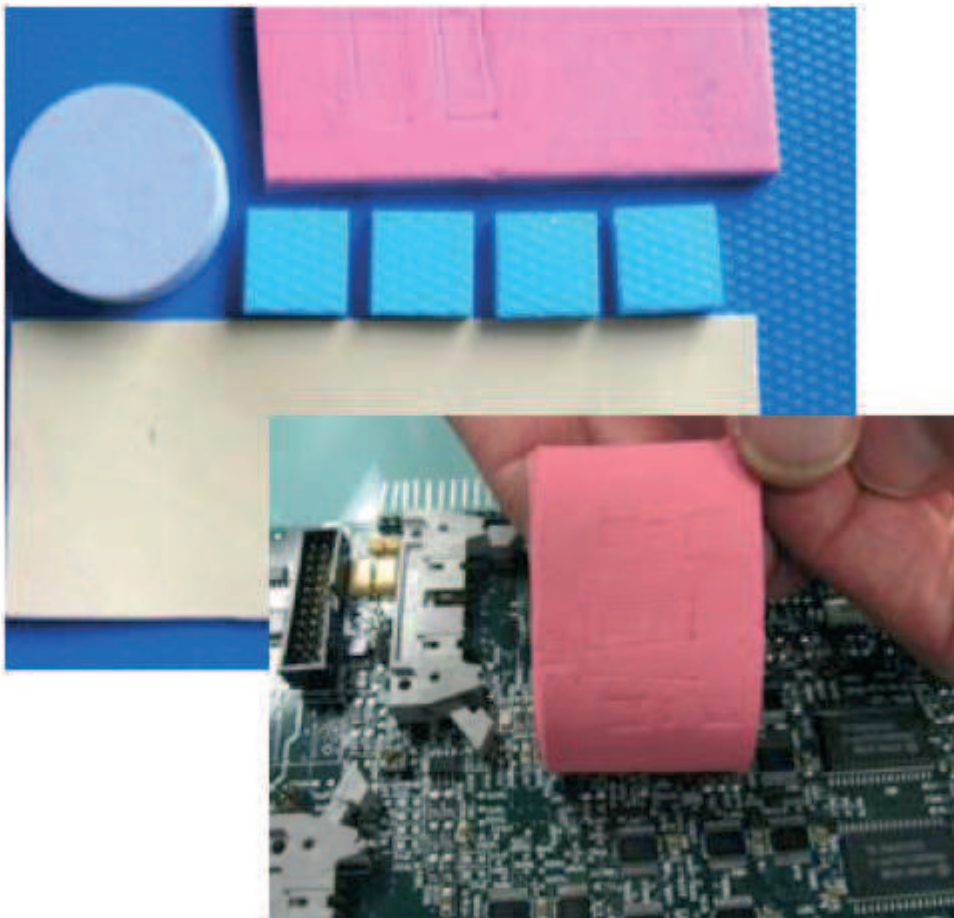
- 570 :** - Peu coûteux, bonne performances thermiques
 - Faible force de fléchissement
 - Idéal pour le moulage de pièces complexes

- 579 :** - Conductivité thermique la plus élevée
 - Très faible force de fléchissement pour des applications à faible contrainte et à charge thermique élevée.
 - Haute conformité
 - Version « G » disponible en épaisseurs de 0.25 mm et 0.40 mm

Epaisseur standard (mm) :

✓ 0.25/0.40/0.50/0.80/1.00/1.30/1.50/1.80/2.00/2.50/3.30/4.10/5.10

* Nous consulter pour autres épaisseurs.



• **MATELAS THERMOCONDUCTEURS NON SILICONÉS**

THERM-A-GAP™ 575-NS

Les élastomères THERM-A-GAP™ sont utilisés pour remplir les espaces entre les cartes de circuit imprimé, les composants, les radiateurs et les boîtiers en métal.

L'adaptabilité de ces matériaux avancés leur permet de recouvrir des surfaces très inégales et de dissiper la chaleur de chaque composant ou de cartes entières, permettant ainsi aux boîtiers d'être utilisés comme distributeurs de chaleur dans les endroits où l'espace est restreint.

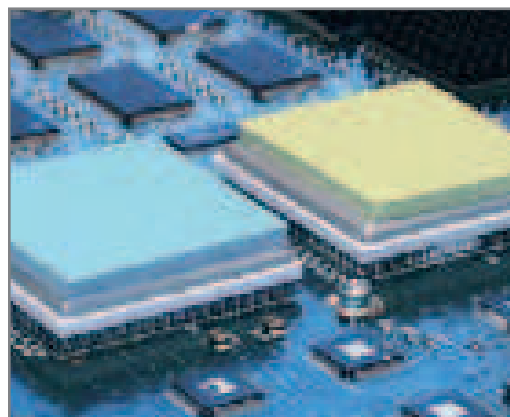
Caractéristiques et avantages :

- Matelas en acrylique chargé en céramique, idéal pour les espaces compris entre 0.5 et 2.5 mm env.
- Excellentes performances thermiques
- Aucun dégazage ni exsudation
- Conforme aux spécifications RoHS
- Faible force de fléchissement requise

Matelas thermoconducteurs en acrylique sans silicone THERM-A-GAP™	
Propriétés standard	575-NS
Couleur	Jaune
Composition	Acrylique rempli de céramique
Epaisseur, mm	0.5 - 2.5 mm
Poids spécifique	1.8
Conductivité thermique, W/m.K	1.2
Dureté (Shore 00)	70
Plage de températures de fonctionnement, °C	-20 à 100 (-4 à 212)

Epaisseurs disponibles (mm) :

✓ 0.5/1/1.2/1.5/2/2.5



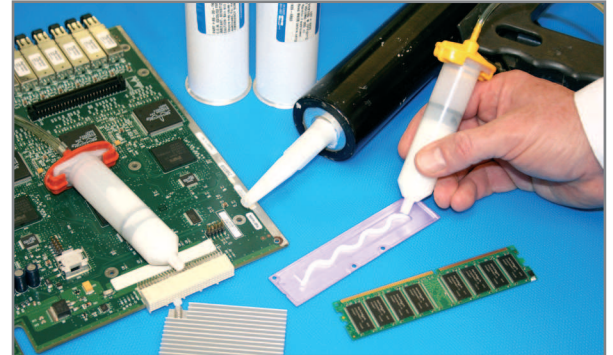
• **MATELAS THERMOCONDUCTEURS AMOVIBLES ENTièrement POLYMÉRISÉS,** **THERM-A-GAP série T63X**

Ces produits sont des Composés hautement adaptables, prépolymérisés à composant unique. Ces matériaux permettent une forte diminution des contraintes mécaniques sur les composants fragiles par rapport aux matelas standard.

Ils sont idéals pour remplir l'espace inégal qui existe entre plusieurs composant et un radiateur standard

Caractéristiques et avantages :

- Pour dépose
- Entièrement polymérisés
- Pas de dépôt de stockage
- Hautement déformable à faibles pressions
- Disponibles avec billes de verre de 0.25 mm créant des arrêts de compression pour l'isolement électrique



Pâtes thermoconductrices THERM-A-GAP™ Série T63X			
Propriétés standard	T630/T630G	T635	T636
Couleur	Blanc	Blanc	Jaune
Poids spécifique	2.25	1.20	1.20
Pourcentage de fléchissement à différentes pressions	Fléchissement,%	Fléchissement,%	Fléchissement,%
à 34 kPa	28	17	17
à 69 kPa	43	33	33
à 172 kPa	50	45	45
à 345 kPa	>60	>60	>60
Conductivité thermique, W/m.K	0.7	1.7	2.4
Capacité thermique, J/g.K	1.1	0.9	0.9
Coefficient de dilatation thermique, ppm/K	350	400	400
Plage de températures de fonctionnement, °C	-55 à 200	-55 à 200	-55 à 200
Force diélectrique, KVca/mm	5.5	5.0	5.0
Résistivité volumique, Ohm.cm	10		
Constance diélectrique à 1 000 kHz	5.5	4.0	4.0
Coefficient de dissipation à 1 000 kHz	0.010	0.003	0.003
Indice d'inflammabilité	V0	Non testé	V0
Conforme aux spécifications RoHS	Oui	Oui	Oui
Dégazage, % TML	0.55	0.5	0.4
Durée limite de stockage, en mois à partir de la date de fabrication	18	18	18

T630/ : - Fiabilité prouvée depuis des années dans des applications grand volume

T630G - Pour utilisation standard

- Bonnes performances thermiques
- Faible force de fléchissement requise
- Contrainte minimale sur les composants
- Version « G » avec billes de verre de 0.25 mm créant des arrêts de compression pour l'isolement électrique

T635 : - Excellentes performances thermiques
- Faible force de fléchissement requise
- Contrainte minimale sur les composants

T636 : - Excellentes performances thermiques
- Pour les problèmes de transfert de chaleur les plus complexes
- Faible force de fléchissement requise
- Contrainte minimale sur les composants